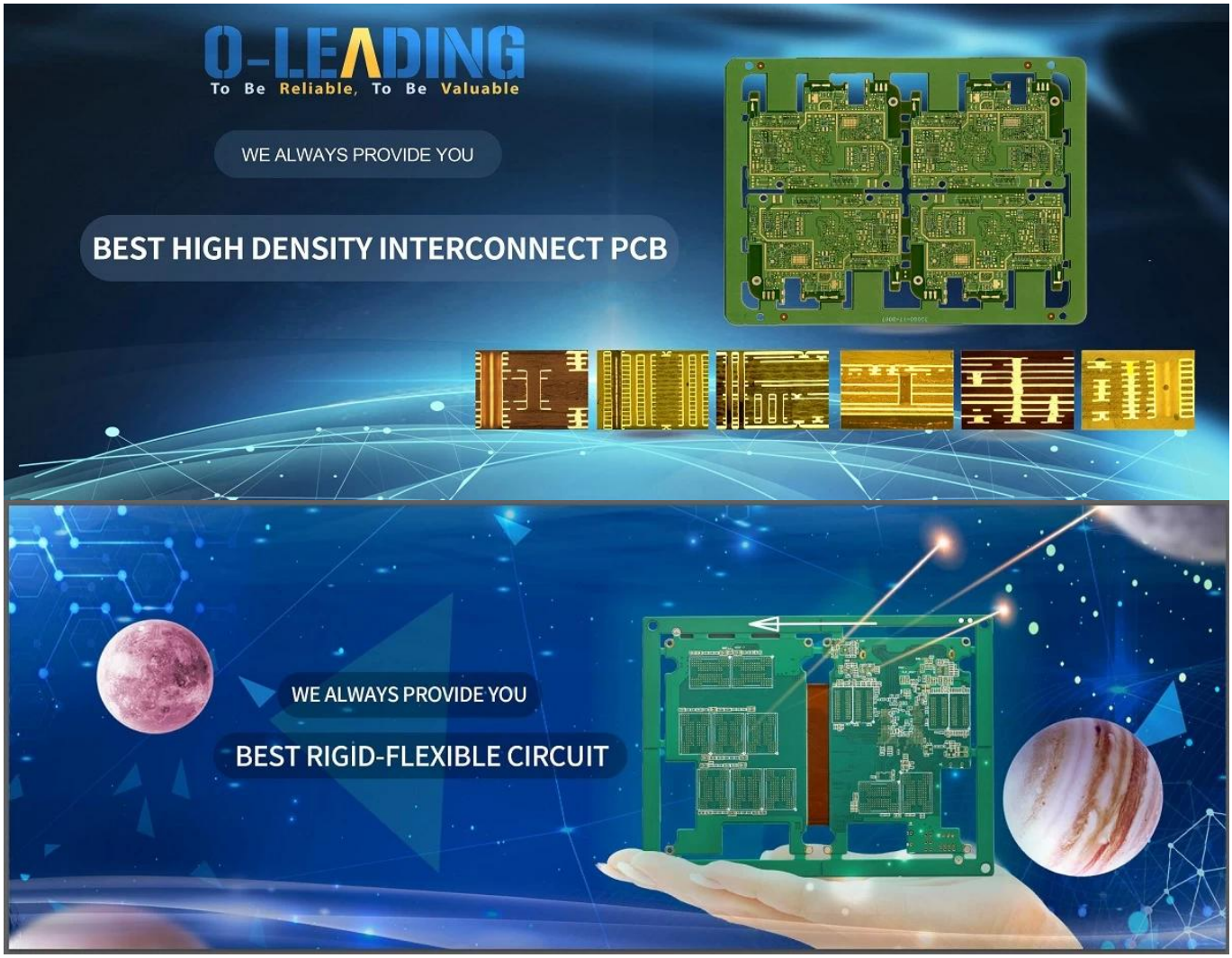
Tervetuloa O-Leadingiin

O-Leading pyrkii olemaan yhden luukun kumppanisi EMS-toimitusketjussa, mukaan lukien piirilevyjen suunnittelu, piirilevyjen valmistus ja piirilevyjen kokoonpano (**Kiina PCB Assembly PCBA Valmistaja**), Tarjoamme joitain edistyneimpiä piirilevytekniikoita, mukaan lukien HDI-piirilevyt, monikerroksiset piirilevyt, jäykät ja joustavat piirilevyt.Voimme tukea nopean käännöksen prototyypistä keski- ja massatuotantoon.

Yleisesti ottaen maailmanlaajuiset asiakkaamme ovat erittäin vaikuttuneita palveluistamme: nopea reagointi, kilpailukykyinen hinta ja sitoutuminen laatuun. Arvokkaamman teknisen palvelun ja kokonaisratkaisun tarjoaminen on tapa johtaa O: ta eteenpäin.

Tulevaisuuden näkökulmasta O-Leading keskittyy elektroniikan valmistusteknologian innovaatioihin ja kehitykseen kuten aina, ja pyrkii jatkuvasti jatkamaan piirilevyjen ja PCBA: n yhden luukun palvelua tarjoamaan ensiluokkaisia palveluja ja luomaan enemmän arvoa asiakkaillemme.

LISÄÄ TIETOJA KLIKKAAMALLA NÄITÄ **OEM PCBA -kokoava suojapiirilevy**

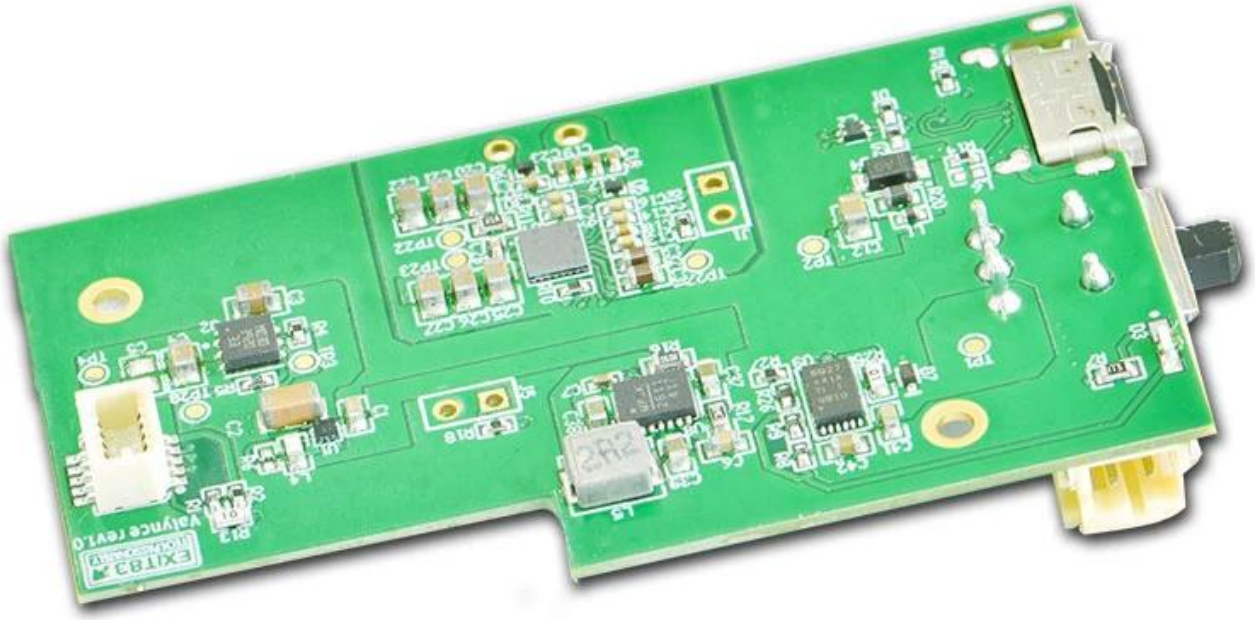


Tuotteen Kuvaus

TOP QUALITY PCBA

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

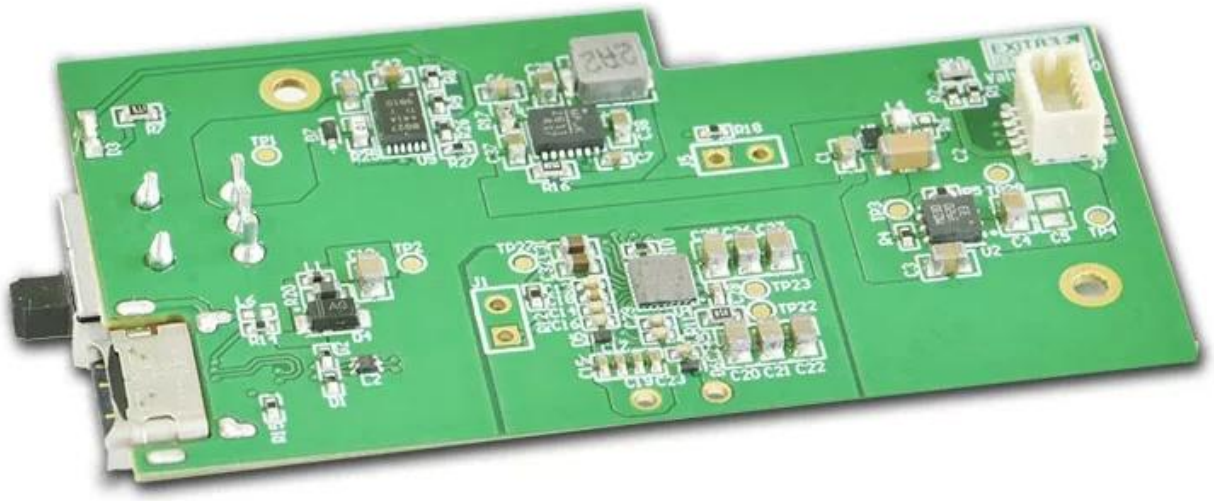


MAKE YOUR IDEA COME TRUE

TOP QUALITY PCBA

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

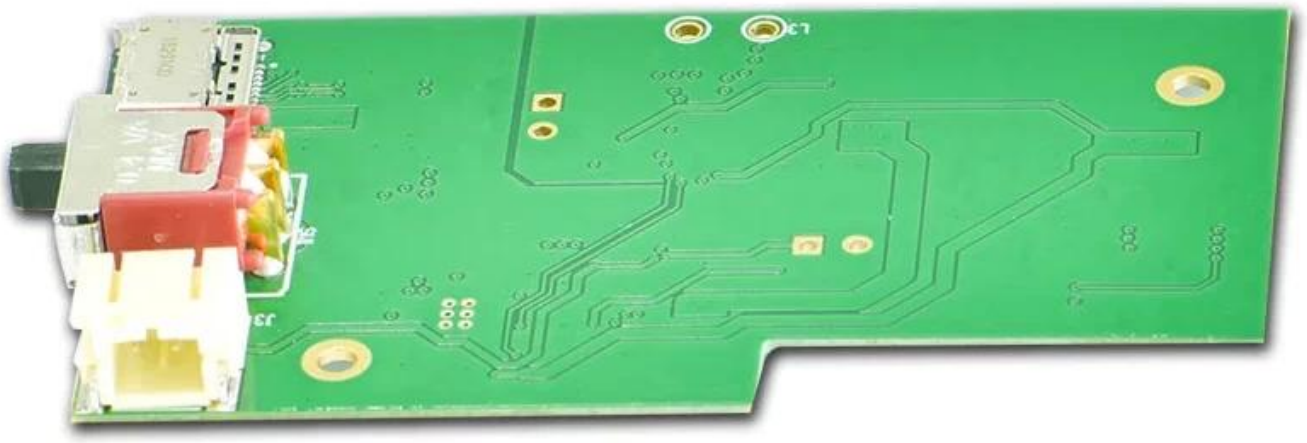


MAKE YOUR IDEA COME TRUE

TOP QUALITY PCBA

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

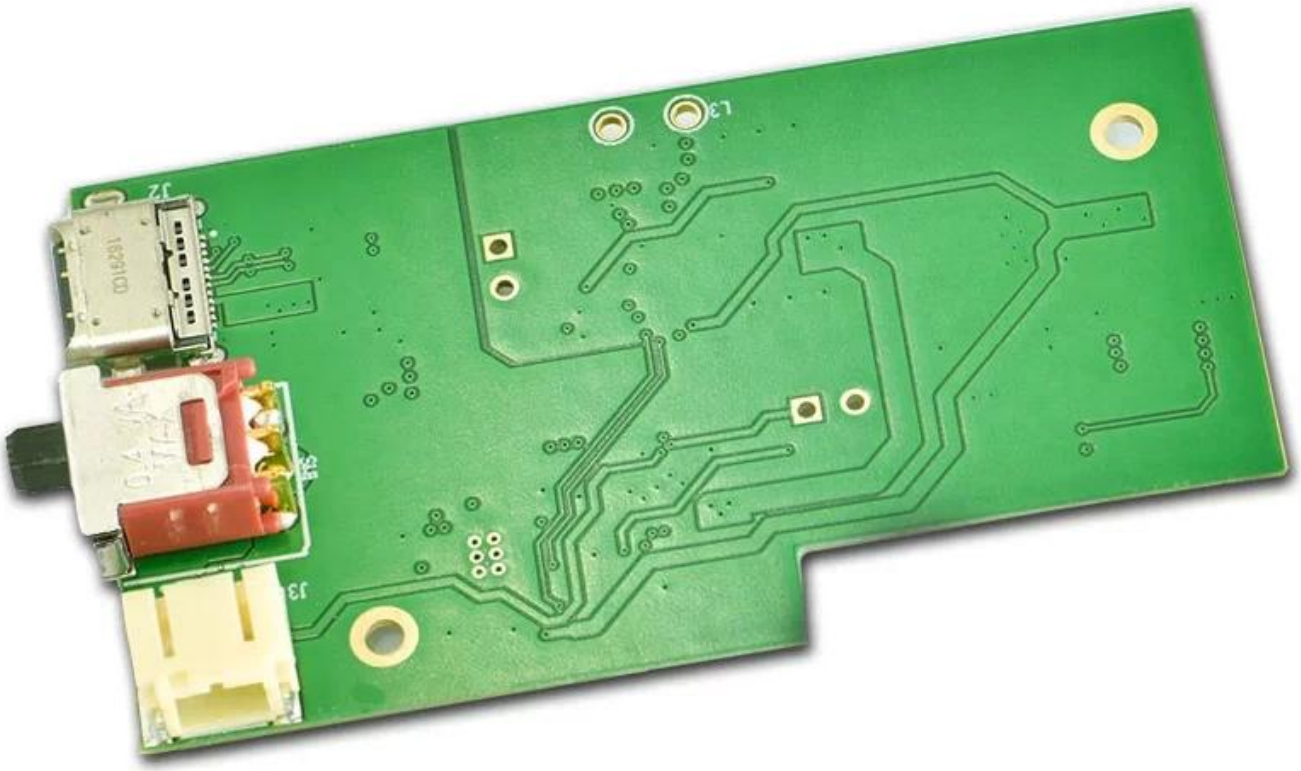


MAKE YOUR IDEA COME TRUE

TOP QUALITY PCBA

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

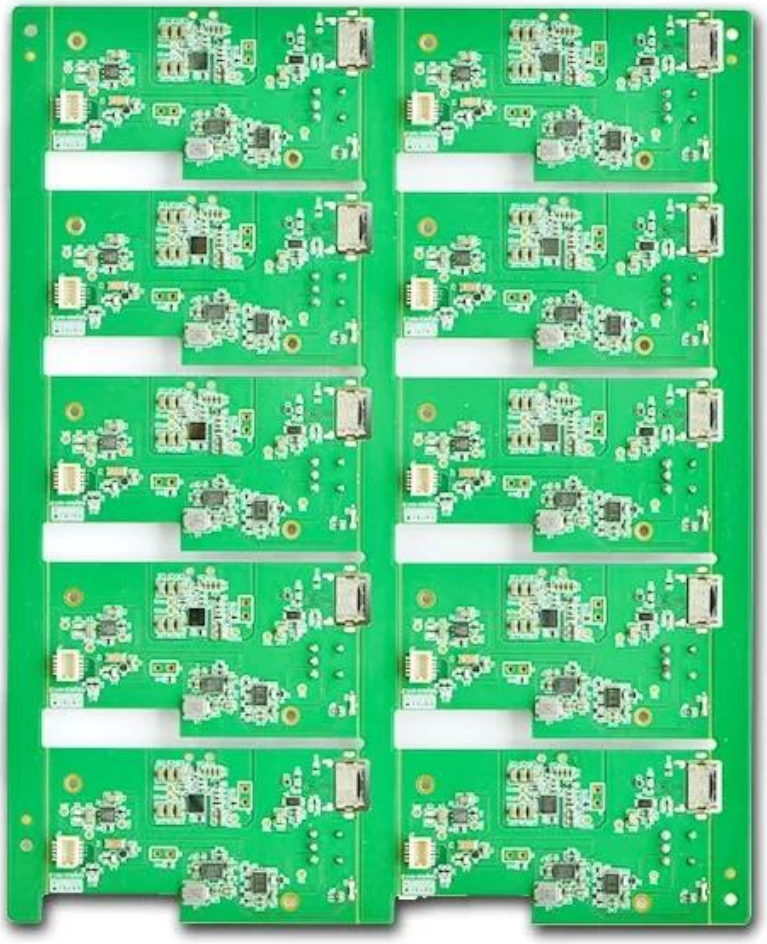


MAKE YOUR IDEA COME TRUE

TOP QUALITY PCBA

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

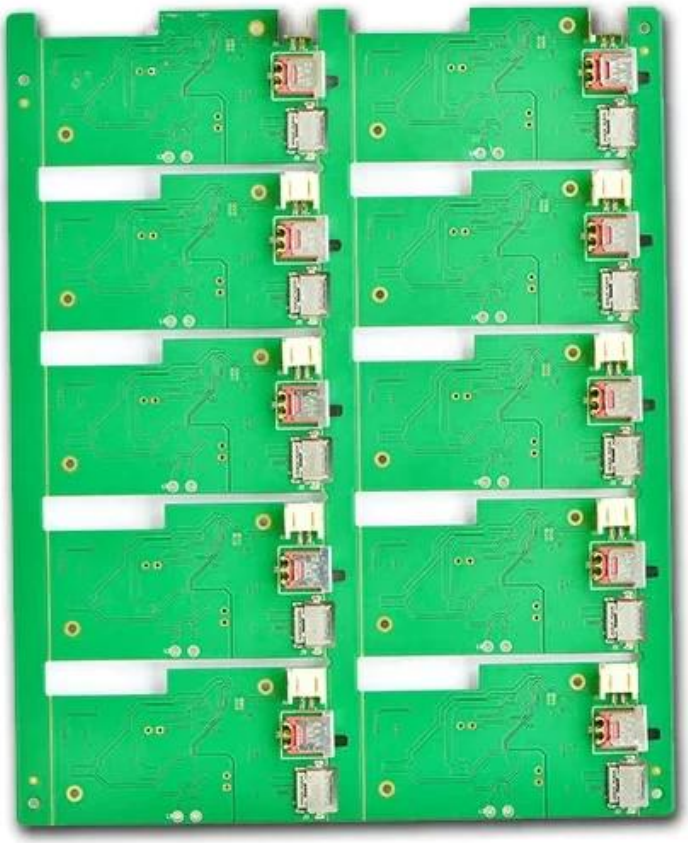


MAKE YOUR IDEA COME TRUE

TOP QUALITY PCBA

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

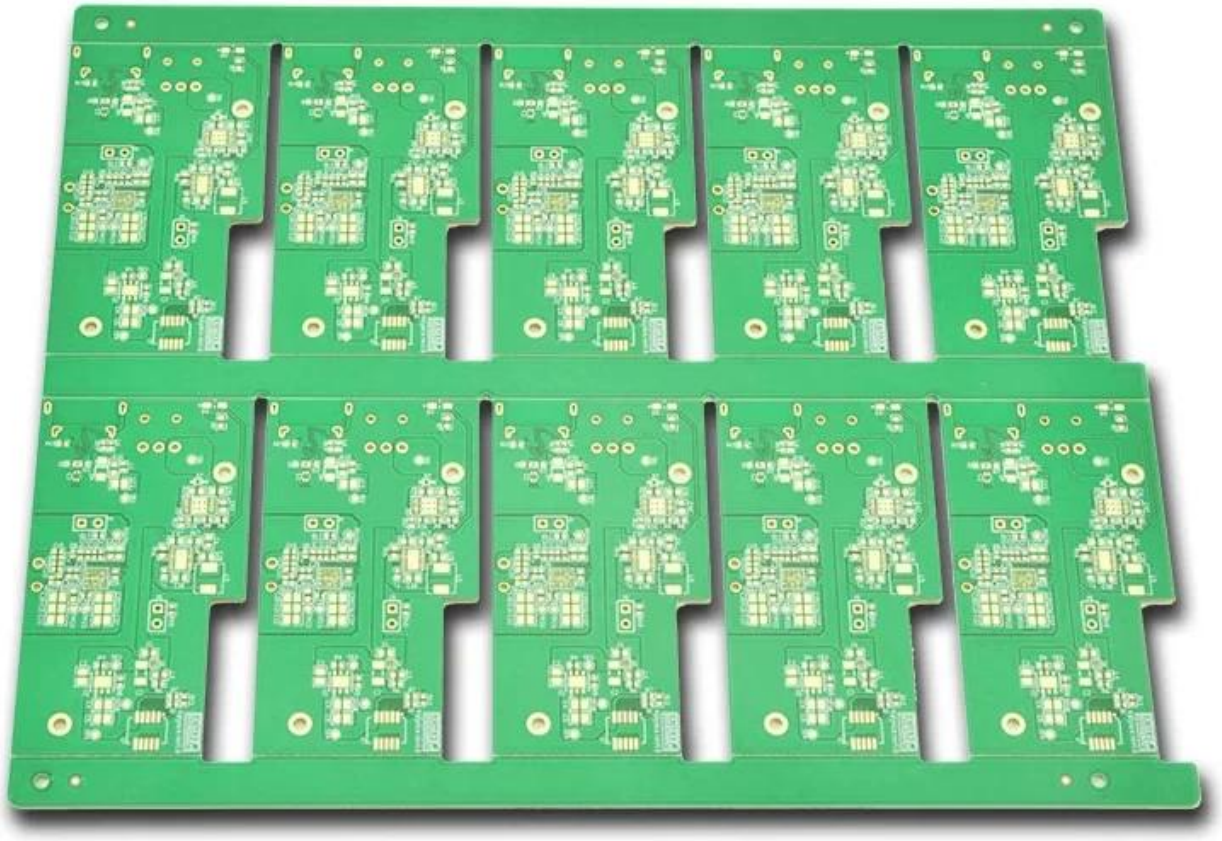


MAKE YOUR IDEA COME TRUE

TOP QUALITY PCBA

O-LEADING

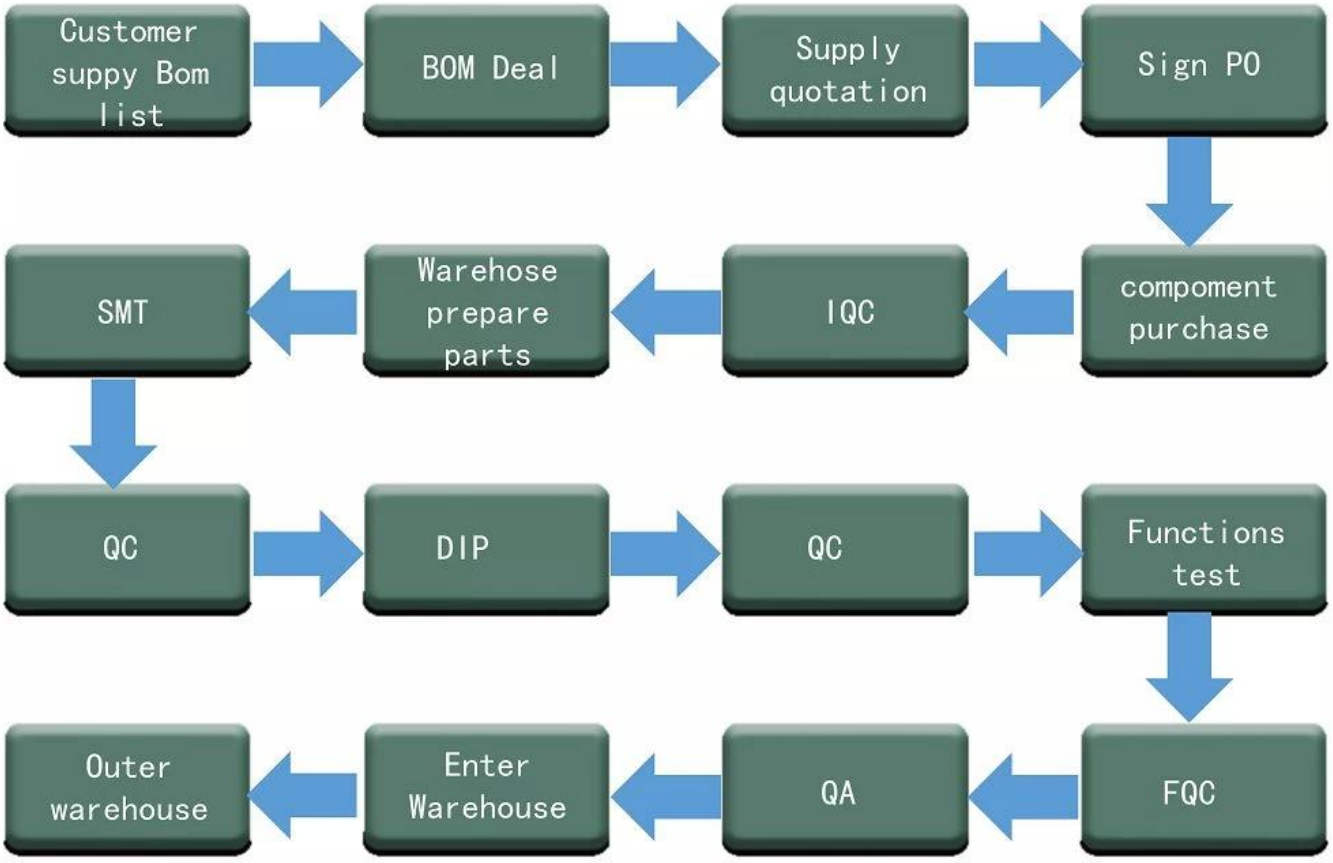
To Be Reliable, To Be Valuable



MAKE YOUR IDEA COME TRUE

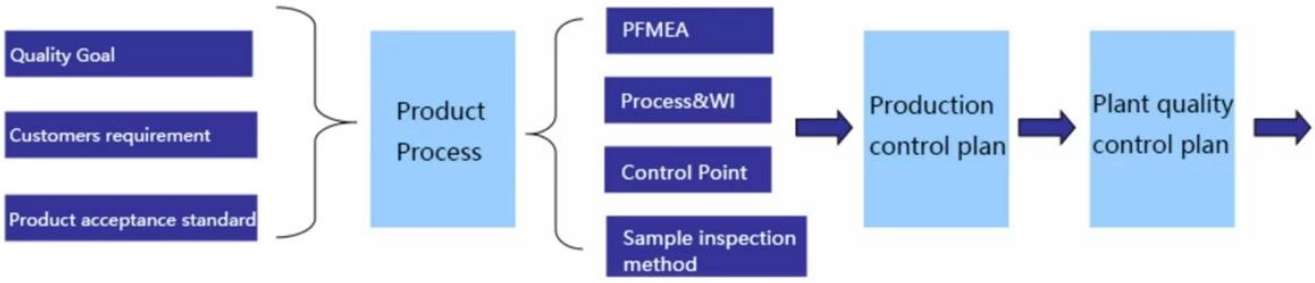
Process Flow Chart

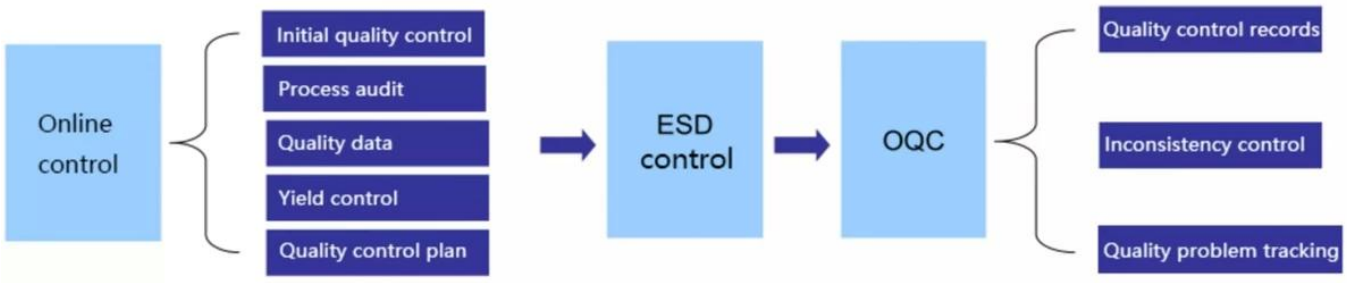
O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable



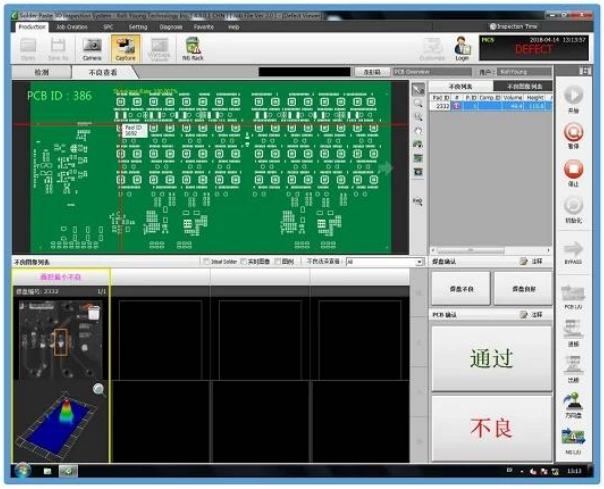
Quality Control Process

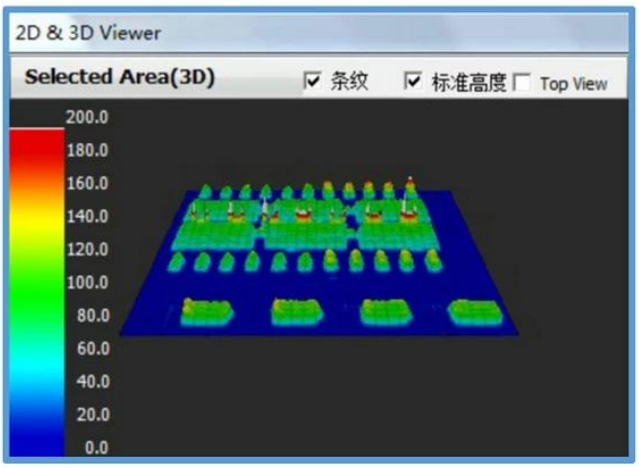
O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

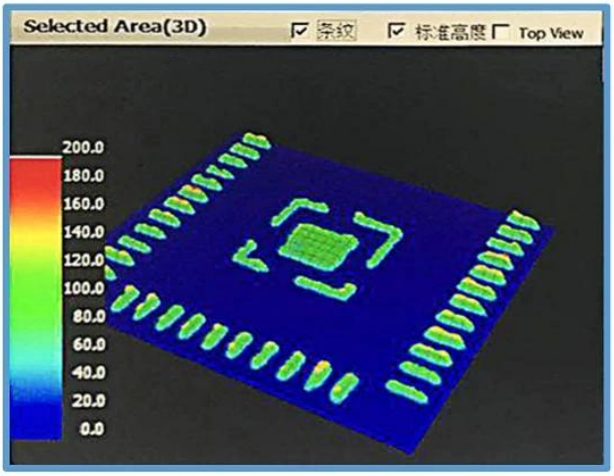




KOHYOUNG solder pasteig check SPI Figure 3 d imaging







Tiimimme

O-LEADING CUSTOMER

To be RELIABLE

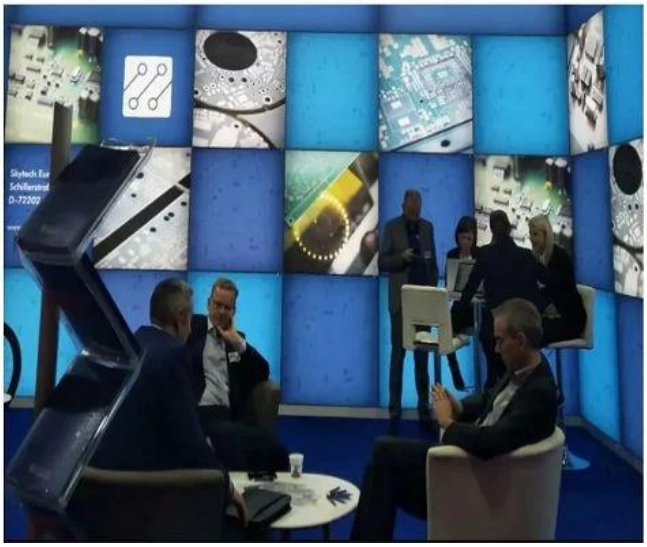
Quality first ,

Customer supreme ,

Scientifically management ,

Striving for famous brand

THE CUSTOMER IS KING



To be VALUABLE

Science and technology keeps head ,

Put people first,

Be precise and practical,

contribute sincerely

Factory PCB

Automatic vacuum press machine

Drilling Machine

Pattern Plating Machine

Scrubbing Machine

Developing Machine

Routing Machine

High-speed flying probe machine

E-test Machine

Factory SMT

HOW O-LEADING MAKE A PROJECT FOR YOU

ırdware Dispenser Application Not

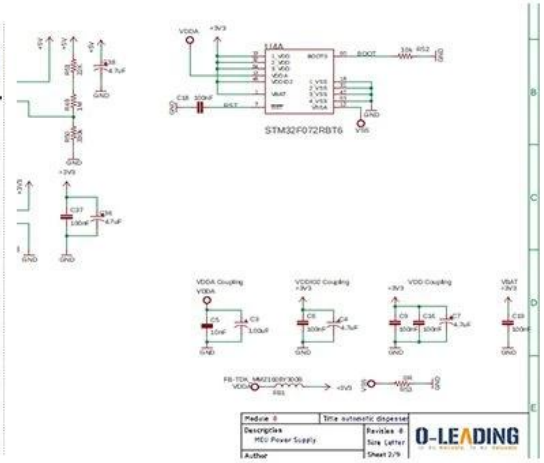
Automatic Dispenser Application Not

Voltage Table

Volt Pin Number	Description
VDD	Battery Voltage
+3V3	+3.3V
+5V	+5V
USB_+5V	USB 5V input
+5V/2	Isolated +5V
+12V	12V DC Drive

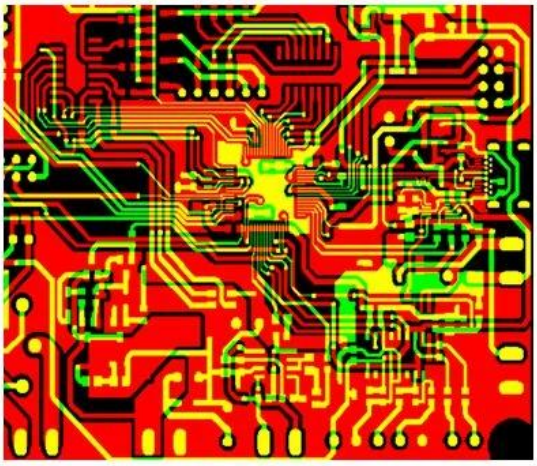
STM32F072 PINOUT table

Wire Name	Description	DIO	Mode	Note
SHTN_TOF	Shutdown Time of flight sensor		Output	Logic '0' to shutdown
I2C_SCL_TOF	I2C communication with time of		I2C1 SCL	
I2C_SDA_TOF	flight sensor		I2C1 SDA	
I2C_SCL_IR	I2C communication with		I2C2 SCL	
I2C_SDA_IR	thermopile sensor		I2C2 SDA	
RATE_LC	Load cell control pins		Output	
DOUT_LC			Output	

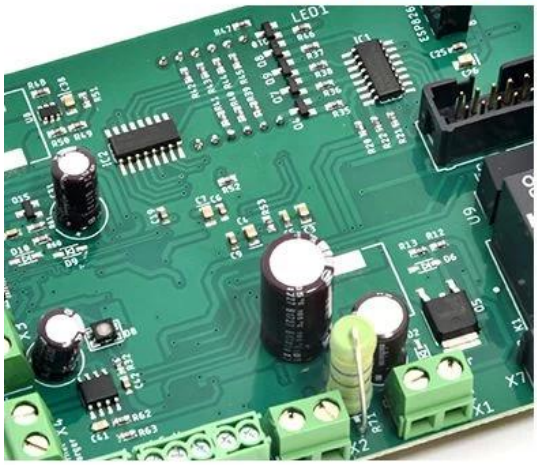


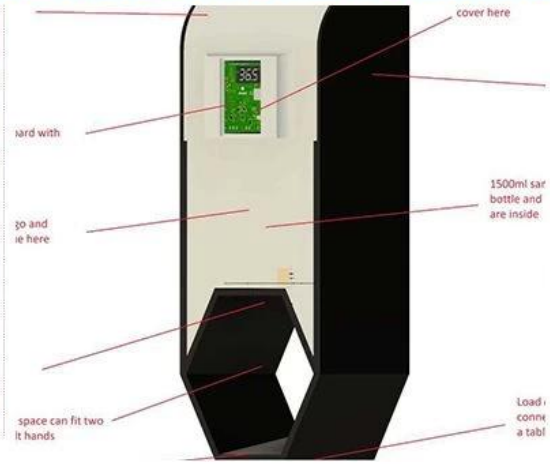
HARDWARE schematics

PCB PRODUCTION COMPONNETS SOURCING



Qty	Value	Device	Parts	Description
4	AK500/2	AK500/2	X1, X2,	CONNECTOR
1	AK500/3	AK500/3	X7	CONNECTOR
1	1241148	MA04-2	SV2	
1	PPPC04	MA04-2	SV1	8 POS , 4*2 FEMALE PIN HEADE
1	ML10	ML10	SV4	HARTING
1	8MHZ	XTALL_CSTCE8M	X5	CSTCE8M00G52-R0 RESONATOR
1	0R	R-0603	R53	Thick Film Resistors - SMD 0603
2	10R	R-0603	R12, R5	Thick Film Resistors - SMD 0603
8	100R	R-0603	R1, R2,	Thick Film Resistors - SMD 0603
1	270R	R-0805	R15	Thick Film Resistors - SMD 0605
1	330R	R-0603	R11	Thick Film Resistors - SMD 0603
9	680R	R-0603	R20, R3	Thick Film Resistors - SMD 0603
17	1k	R-0603	R9, R10	Thick Film Resistors - SMD 0603
2	4.7k	R-0603	R17, R6	Thick Film Resistors - SMD 0603
2	5.1k	R-0603	R18, R1	Thick Film Resistors - SMD 0603
9	10k	R-0603	R16, R3	Thick Film Resistors - SMD 0603





PCB Assembly MECHANICAL DESIGN

Skyworth 创维

和而泰
H&T INTELLIGENT CONTROL

dongweikeji
东威科技

美的 Midea

STAR-NET
星网锐捷

FORYOU
ADAYO
华阳集团

EDIFIER®

Cultraview 金锐显

3nod三诺

T&W

TCL

AcBel
康舒科技
ACBEL POLYTECH INC.

Honeywell

Schneider
Electric

ZTE中兴

EMERSON.

BYD

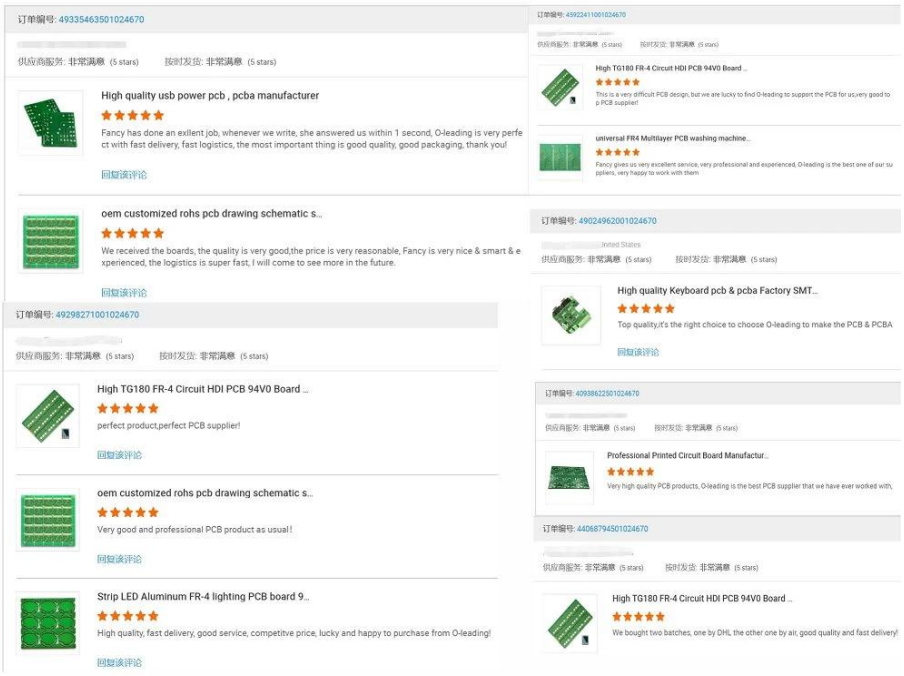
PHILIPS

TE
connectivity

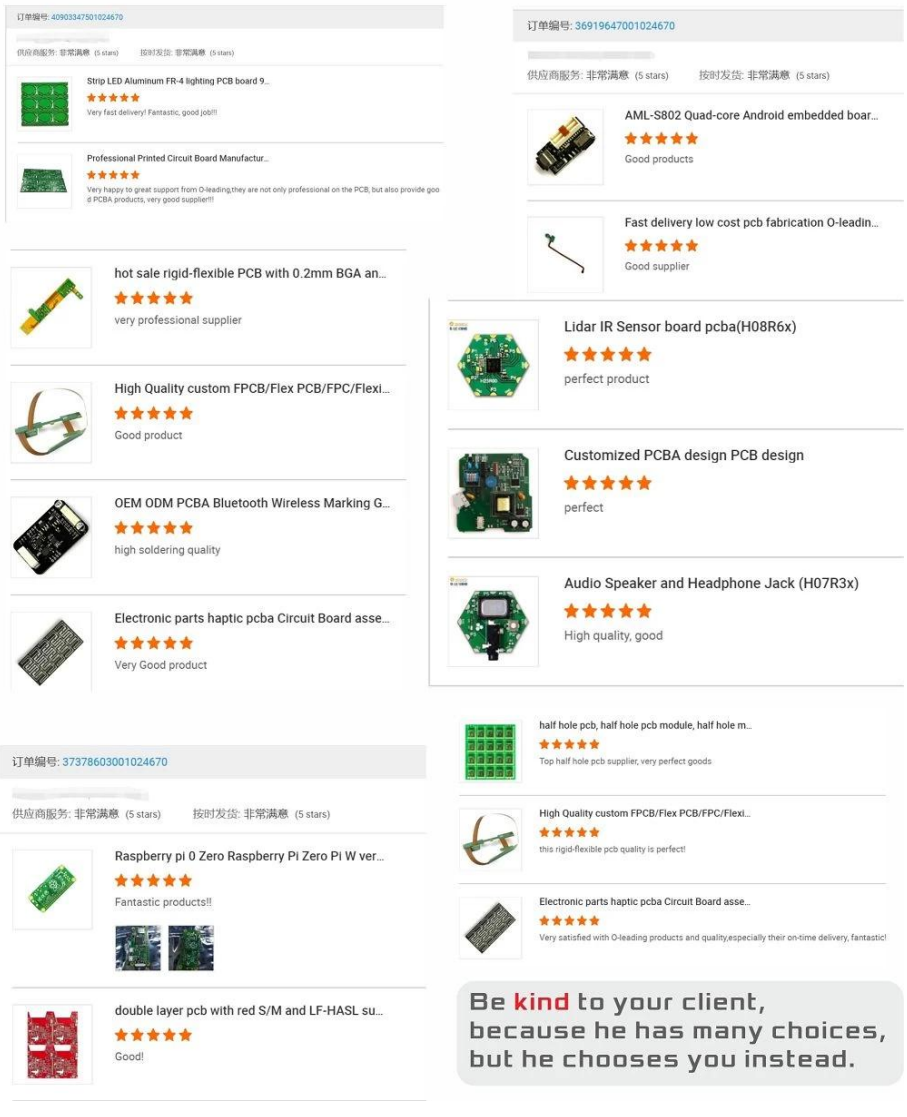
VIDEOTON

O-LEADING CUSTOMER REVIEW

CUSTOMER VOICE IS EXTREMELY IMPORTANT TO US



LISTEN TO CUSTOMER VOICE



Be kind to your client, because he has many choices, but he chooses you instead.

Sertifikaatit

O-LEADING TRAINING

Keep LEARNING

There's a phrase in Buddhism, 'Beginner's mind.'

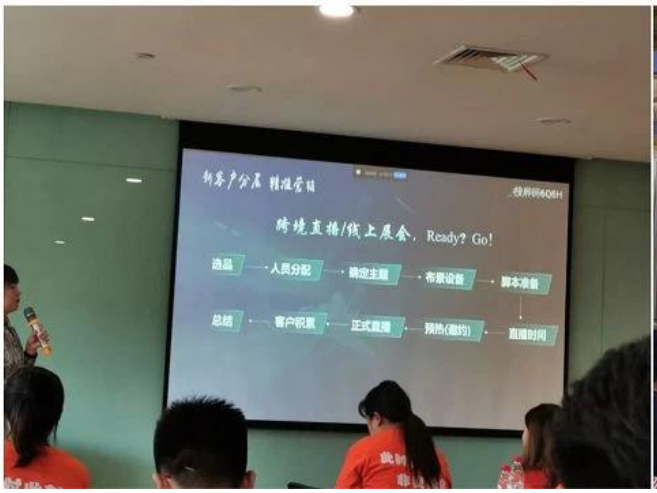
It's wonderful to have a beginner's mind

WE HAVE A DREAM

Keep RUNNING

I would like to live to study and not study to live.

----Bacon



CICC CERTIFICATION
嘉泰认证

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No: 18118Q10347R0S

We hereby certify that

O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED

Credit No: 61691591-000-07-18-7

Registration Add: FLAT/RM 1205 12/F TAI SANG BANK BUILDING 130-132 DES VOEUS ROAD CENTRAL HK

Business Add: 1313, Floor 13, Fortune Building, Danshui Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Has implemented and maintains a **Quality Management System**

Which fulfils the requirements of the following standards

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Scope of certification

Sales of printed circuit boards

Initial Issuance period: February 27, 2018

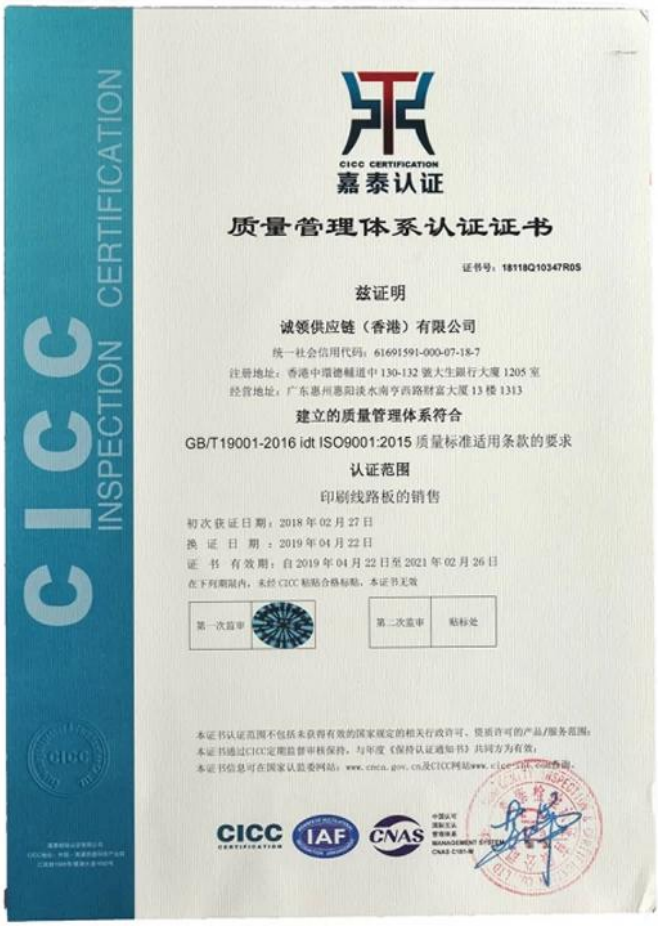
Renewal date: April 22, 2019

This certificate is valid during: April 22, 2019 ~ February 26, 2021

This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period

First supervision and audit		Second supervision and audit	Qualified mark

CICC IAF CNAS



CICC CERTIFICATION
嘉泰认证

质量管理体系认证证书

证书号：18118Q10347R0S

兹证明

诚领供应链（香港）有限公司

统一社会信用代码：61691591-000-07-18-7

注册地址：香港中环德輔道中130-132號大生銀行大廈 1205 室

经营地址：广东惠州惠阳淡水南亨西路财富大厦13楼1313

建立的质量管理体系符合

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 质量标准适用条款的要求

认证范围

印刷线路板的销售

初次获证日期：2018年02月27日

换 证 日 期 ：2019年04月22日

证 书 有效期：自2019年04月22日至2021年02月26日

在下列期限内，未经CICC贴标合格标贴，本证书无效

第一次监审		第二次监审	贴标处

CICC IAF CNAS

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO.,LIMITED

1313,FLOOR 13, FORTUNE BUILDING, DANSHUI TOWN, HUIYANG DISTRICT, HUIZHOU, GUANGDONG, CHINA

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the clients as : OSP

SGS Job No. :	RP19-005089 - SZ
Date of Sample Received :	22 Mar 2019
Testing Period :	22 Mar 2019 - 30 Mar 2019
Test Requested :	Selected test(s) as requested by client.
Test Method :	Please refer to next page(s).
Test Results :	Please refer to next page(s).
Conclusion :	Based on the performed tests on submitted sample(s), the results of Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls (PBBs), Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and Phthalates such as Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) , Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP) , and Diisobutyl phthalate (DIBP) comply with the limits as set by RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shenzhen Branch

Tina

Tina Fan
Approved Signatory

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.
Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

SGS Bldg, No.2, Jianghua Industrial Park, No.430, Jihua Road, Bantian, Longgang District, Shenzhen, China 518129 t (86-755) 25328888 f (86-755) 83106190 www.sgsgroup.com.cn
中国·深圳·龙岗区坂田吉华路430号江灏工业园4栋SGS大厦 邮编: 518129 t (86-755) 25328888 f (86-755) 83106190 e sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

Test Results :

Test Part Description :

Specimen No.	SGS Sample ID	Description
SN1	SZX19-005304.001	Green"PCB"

Remarks :

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
(2) MDL = Method Detection Limit
(3) ND = Not Detected (< MDL)
(4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method : With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC62321-5:2013, IEC62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	001
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	8
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (Cr(VI))	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.
Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

SGS Bldg, No.2, Jianghua Industrial Park, No.430, Jihua Road, Bantian, Longgang District, Shenzhen, China 518129 t (86-755) 25328888 f (86-755) 83106190 www.sgsgroup.com.cn
中国·深圳·龙岗区坂田吉华路430号江灏工业园4栋SGS大厦 邮编: 518129 t (86-755) 25328888 f (86-755) 83106190 e sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

UL Product iQ™

ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD
ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG

E490354

Type	Cond Width Min mm(in)	Min Edge mm(in)	Cond Thk mic(mil)	SS/ DS/ DSO	Max Area Diam mm(in)	Solder Limits C	sec	Max Oper Temp C	Flame Class	Meets UL796 DSR	CTI
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.											
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	-
Multilayer printed wiring boards.											
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*
Single layer printed wiring boards.											
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲	*
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL 跟踪检验服务的要求。只有带有 UL 标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL 跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.“经 UL 允许从在线认证目录转载”声明必须出现在所摘取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明： "© 2019 UL LLC"

Prosessikapasiteetti

Piirilevyjen tuotantokapasiteetti	
Kerroslaskenta	1 kerros-32 kerros
Valmiit kuparipaksuudet	1 / 3oz-12oz
Pienin viivan leveys / sisäinen etäisyys	3,0mil / 3,0mil
Pienin viivan leveys / väli ulkoinen	4,0mil / 4,0mil
Suurin kuvasuhde	10: 1
Levyn paksuus	0,2 - 5,0 mm
Paneelin enimmäiskoko (tuumaa)	635 * 1500mm
Porattu reikien vähimmäiskoko	4mil
Kiinnitetty reiän suvaitsevaisuus	+/- 3mil
BIind / Buried Vias (AII-tyypit)	JOO
Täytön kautta (johtava, ei-johtava)	JOO
Pohjamateriaalia	FR-4, FR-4korkea Tg Halogeeniton materiaali, Rogers, Alumiinipohja,Polyimidi, raskas kupari
Pintakäsittely	HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, lmmersion hopea,Lmmersion Tin, kultaiset sormet, hiilimustetta

SMT-tuotantokapasiteetti

PCB-materiaali	FR-4, CEM-1, CEM-3, alumiinipohjainen levy, FPC
Max PCB-koko	510x1500mm
Pienin piirilevykoko	50x50mm
Piirilevyn paksuus	0,5 - 4,5 mm
Levyn paksuus	0,5-4 mm
Komponenttien vähimmäiskoko	0201
Normaali sirukokoinen komponentti	0603 tai suurempi
Komponentin enimmäiskorkeus	15mm
Pienin lyijyn nousu	0,3 mm
Pienin BGA-pallokenttä	0,4 mm
Sijoittamisen tarkkuus	+/- 0,03 mm

Pakkaus ja toimitus

Shipping service

DHL WORLDWIDE EXPRESS TNT FedEx Express UPS

Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

UKK

1. Kuinka O-Leading varmistaa laadun?
Korkea laatutaso saavutetaan seuraavilla tavoilla.
1.1 Prosessia valvotaan tiukasti ISO 9001: 2008 -standardien mukaisesti.
1.2 Ohjelmistojen laaja käyttö tuotantoprosessin hallinnassa
1.3 Huipputason testauslaitteet ja työkalut. Esimerkiksi. Flying Probe, röntgentarkastus, AOI (automatisoitu optinen tarkastaja) ja ICT (piirin sisäinen testaus).
1.4 Erityinen laadunvarmistusryhmä vikatapausten analysointiprosessilla
1.5 Henkilöstön jatkuva koulutus

2. Kuinka O-Leading pitää hintasi kilpailukykyisenä?
Viime vuosikymmenen aikana monien raaka-aineiden (esim. Kupari, kemikaalit) hinnat ovat kaksinkertaistuneet, kolminkertaistuneet tai nelinkertaistuneet; Kiinan valuutan RMB oli noussut 31% Yhdysvaltain dollariin nähden; Ja myös työvoimakustannuksemme nousivat merkittävästi.
O-Leading on kuitenkin pitänyt hintamme vakaana. Tämä omistaa kokonaan innovaatiomme kustannusten vähentämisessä, jätteiden välttämisessä ja tehokkuuden parantamisessa. Hintamme ovat erittäin kilpailukykyisiä teollisuudessa samalla laatutasolla.
Uskomme win-win-kumppanuuteen asiakkaidemme kanssa. Kumppanuudestamme on molemminpuolista hyötyä, jos voimme tarjota sinulle edun kustannuksia ja laatua. (**FAst Delivery Double Side PCB**

Board Valmistaja)

3. Millaisia levyjä O-johtava voi käsitellä?
Yleiset FR4-, korkea-TG- ja halogeenittomat levyt, Rogers, Arlon, Telfon, alumiini / kuparipohjaiset levyt, PI jne.

4. Mitä tietoja tarvitaan PCB- ja PCBA-tuotantoon?
4.1 BOM (Bill of Materials) viitetunnisteilla: osan kuvaus, valmistajan nimi ja osanumero.
4.2 Piirilevyn Gerber-tiedostot.
4.3 Piirilevyjen valmistuspiirustus ja PCBA-kokoonpanopiirustus.
4.4 Testimenettelyt.
4.5 Mahdolliset mekaaniset rajoitukset, kuten kokoonpanon korkeusvaatimukset.

5. Mikä on tyypillinen prosessivirta monikerroksiselle piirilevylle?
Materiaalin leikkaus → Sisempi kuiva kalvo → sisäinen syövytys → Sisempi AOI → Monisidos → Kerrospino ylös Puristaminen → Poraus → PTH → Paneelipinnoitus → Ulkokuiva kalvo → Kuvion pinnoitus → Ulkoinen syövytys → Ulkoinen AOI → Juotosmaski → Komponenttimerkki → Pintakäsittely → Reititys → E / T → Silmämääräinen tarkastus.

6. Mitkä ovat HDI-valmistuksen tärkeimmät laitteet?
Tärkeimpien laitteiden luettelo on seuraava: Laserporakone, puristuskone, VCP-linja, automaattinen valotuskone, LDI ja niin edelleen.
Laitteemme ovat alan parhaita, laserporakoneet ovat Mitsubishilta ja Hitachilta, LDI-koneet ovat Screeniltä (Japani), Automaattiset valotuslaitteet ovat myös Hitachilta, jotka kaikki tekevät meistä vastaamaan asiakkaan teknisiin vaatimuksiin.

7. Kuinka monen tyyppistä pintakäsittelyä O-lyijy voi tehdä?
O-johtajalla on täysi sarja pintakäsittelyjä, kuten: ENIG, OSP, LF-HASL, kulloitus (pehmeä / kova), uppohopea, tina, hopeapinnoitus, upotettava tinan pinnoitus, hiilimuste ja niin edelleen. HDI: ssä yleisesti käytetty OSP, ENIG, OSP + ENIG, suosittelemme yleensä asiakkaan tai OSP OSP + ENIG: n käyttöä, jos BGA PAD -koko on alle 0,3 mm.

8. Mikä on kykysi FPC: lle? Voiko O-Leading tarjota myös SMT-palvelua?
O-Leading voi valmistaa FPC: n yksikerroksisesta 8-kerrokseen, työpaneelin koko voi olla jopa 2000 mm * 240 mm, katso yksityiskohdat sivulta “Flex Capability”
Tarjoamme myös SMT yhden luukun palvelua asiakkaalle.

9. Mitkä ovat tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat piirilevyn hintaan?
Materiaali;
Pinnan viimeistely;
Teknologian vaikeus;
Erilaiset laatukriteerit;
PCB-ominaisuudet;
Maksuehdot;
Eri valmistusmaat.

10. Mikä on PCB: n, PWB: n ja FPC: n määritelmä ja mikä on ero?
PCB on lyhenne sanoista painettu piirilevy;
PWB on lyhenne sanoista Printed Wire Board, mikä tarkoittaa samaa kuin piirilevy;
FPC on lyhenne sanoista Flexible Printed Board.

11. Mitkä tekijät tulisi ottaa huomioon valittaessa materiaalia piirilevylle?
Seuraavat tekijät on otettava huomioon, kun valitsemme materiaalia PCB: lle:

Materiaalin Tg-arvon tulisi olla suurempi kuin käyttölämpötila;
Matalalla CTE-materiaalilla on hyvä lämpöstabiilisuus;
Hyvä lämmönkestävyys: Normaalisti PCB: n vaaditaan kestämään 250 ℃ vähintään 50 sekunnin ajan.
Hyvä tasaisuus; Sähköisten ominaisuuksien huomioon ottamiseksi suuritaajuisissa piirilevyissä käytetään pienihäviöistä / suurta läpäisevyyttä sisältävää materiaalia; Polyimidilasilasisubstraatti, jota käytetään joustavaan PCB: hen; Metalliydintä käytetään, kun tuotteella on tiukat vaatimukset lämmön haihdutukselta.

12. Mitkä ovat O-Leadingin rIgid-flex PCB: n edut?
O-Leadingin jäykällä joustavalla piirilevyllä on sekä FPC: n että PCB: n merkit, joten sitä voidaan käyttää joissakin erikoistuotteissa. Osa on joustava, kun taas toinen osa jäykkä, se voi säästää tuotteen sisätilaa, vähentää tuotteen määrää ja parantaa suorituskykyä.

13. Kuinka impedanssi lasketaan?
Impedanssinhallintajärjestelmä tehdään käyttämällä joitain testikuponkeja, SI6000 soft- ja CITS 500s -laitteita POLAR INSTRUMENTSilta.
Laite mittaa impedanssin edustavalla radan kokoonpanokupongilla, jonka asiakas on antanut meille määritetyn arvon ja toleranssin.